



平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成31年1月30日

上場会社名	株式会社トーマンデバイス	上場取引所	東
コード番号	2737	URL	http://www.tomendevices.co.jp/
代表者	(役職名) 代表取締役社長	(氏名)	妻木 一郎
問合せ先責任者	(役職名) 経理部長	(氏名)	原 英記
四半期報告書提出予定日	平成31年2月13日	TEL	03-3536-9150
四半期決算補足説明資料作成の有無	無		
四半期決算説明会開催の有無	無		

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第3四半期	148,941	△0.3	2,856	42.6	2,067	23.6	1,438	18.3
30年3月期第3四半期	149,416	31.0	2,002	94.8	1,672	12.9	1,215	9.6

(注) 包括利益 31年3月期第3四半期 1,480百万円 (0.2%) 30年3月期第3四半期 1,476百万円 (17.6%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年3月期第3四半期	211.44	187.93
30年3月期第3四半期	178.75	155.63

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
31年3月期第3四半期	84,539	28,812	33.9	4,213.77
30年3月期	67,673	27,876	41.0	4,080.26

(参考) 自己資本 31年3月期第3四半期 28,659百万円 30年3月期 27,751百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年3月期	—	0.00	—	80.00	80.00
31年3月期	—	0.00	—	—	—
31年3月期(予想)	—	—	—	90.00	90.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成31年3月期の連結業績予想（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	215,000	8.8	3,400	30.8	2,600	7.0	2,000	14.9	294.06

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(注) 詳細は、添付資料6ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご参照下さい。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	31年3月期3Q	6,802,000株	30年3月期	6,802,000株
② 期末自己株式数	31年3月期3Q	611株	30年3月期	611株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	31年3月期3Q	6,801,389株	30年3月期3Q	6,801,455株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	4
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	6
(追加情報)	6
3. 補足情報	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、堅調な企業収益を背景に、設備投資や雇用・所得環境の改善が続き、緩やかな回復が続きました。また世界経済につきましては、通商問題の動向及び影響、金融市場の変動の影響等先行き不透明な状況が続きましたが、緩やかに回復いたしました。

エレクトロニクス業界におきましては、半導体メモリーの価格下落がみられたものの、国内市場は引き続き堅調に推移しました。しかしながら、米中貿易摩擦に端を発した経済の不確実性が世界の实体经济に影響を及ぼし、特に中国では業況の悪化が顕在化しております。

このような状況下、当社グループは、国内市場ではPC、サーバー・ストレージ向けにDRAM、スマートフォン向けにMCP（マルチチップ・パッケージ）、車載向けメモリーをそれぞれ拡販したものの、中国市場では、テレビメーカー向けビジネスの低調により液晶デバイスの販売が減少したこと、CIS（CMOSイメージセンサー）の販売が減少したことから、売上高は1,489億41百万円（前年同期比0.3%減）となりました。しかし、収益性の改善と新規ビジネスの貢献により、営業利益は28億56百万円（同42.6%増）、経常利益は20億67百万円（同23.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は14億38百万円（同18.3%増）となりました。

なお、品目別の実績については、7ページの「3. 補足情報（品目別販売実績）」をご参照ください。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、スマートフォン向けビジネスや新規ビジネス（ファウンドリー）の拡大に伴い、特に商品および前渡金が大幅に増加しました。

総資産の残高は845億39百万円（前連結会計年度末比24.9%増）となりました。これは主に商品および前渡金が増加したことによるものです。

負債の残高は557億27百万円（同40.0%増）となりました。これは主に短期借入金および未払金が増加したことによるものです。

純資産の残高は288億12百万円（同3.4%増）となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上と配当金の支払によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成30年10月26日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

なお、平成30年5月8日、丸文株式会社の100%子会社である丸文セミコン株式会社（以下「丸文セミコン」といいます。）との間で、丸文セミコンが営む日本サムスン株式会社の販売特約店の事業を譲り受けることを決定し、同日付で事業譲渡契約を締結しております。詳細につきましては、平成30年5月8日に公表しました「事業の譲受けに関するお知らせ」をご参照下さい。

本件の譲受け資産は、棚卸資産であり、事業譲渡日（平成30年10月1日）以降に本契約に基づく棚卸資産を譲り受けており、当該棚卸資産の譲受け価額の合計は865百万円となります。負債項目については譲受けを行いません。

これにより、本件の平成31年3月期連結業績に与える影響は、売上高7,300百万円、経常利益40百万円程度を見込みますが、通期の連結業績予想に織り込み済みです。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,131	3,017
受取手形及び売掛金	42,938	43,497
商品	11,847	22,823
前渡金	2,016	12,205
預け金	4,297	851
その他	852	722
流動資産合計	66,083	83,118
固定資産		
有形固定資産	52	44
無形固定資産	250	269
投資その他の資産	1,287	1,107
固定資産合計	1,590	1,421
資産合計	67,673	84,539
負債の部		
流動負債		
買掛金	25,440	26,699
短期借入金	5,879	13,902
未払法人税等	450	444
賞与引当金	128	67
未払金	6,535	12,200
その他	978	2,008
流動負債合計	39,413	55,322
固定負債		
退職給付に係る負債	345	366
その他	38	38
固定負債合計	384	404
負債合計	39,797	55,727
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,054	2,054
資本剰余金	1,984	1,984
利益剰余金	23,040	23,934
自己株式	△1	△1
株主資本合計	27,077	27,971
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	338	236
繰延ヘッジ損益	32	30
為替換算調整勘定	303	420
その他の包括利益累計額合計	674	688
非支配株主持分	124	152
純資産合計	27,876	28,812
負債純資産合計	67,673	84,539

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
売上高	149,416	148,941
売上原価	145,869	144,193
売上総利益	3,546	4,747
販売費及び一般管理費	1,543	1,891
営業利益	2,002	2,856
営業外収益		
受取利息	6	2
受取配当金	13	15
持分法による投資利益	31	—
その他	5	15
営業外収益合計	56	33
営業外費用		
支払利息	166	296
債権売却損	15	35
支払手数料	7	—
為替差損	183	403
持分法による投資損失	—	68
その他	13	17
営業外費用合計	386	822
経常利益	1,672	2,067
税金等調整前四半期純利益	1,672	2,067
法人税等	434	606
四半期純利益	1,238	1,461
非支配株主に帰属する四半期純利益	22	23
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,215	1,438

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
四半期純利益	1,238	1,461
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	225	△101
繰延ヘッジ損益	△23	△1
為替換算調整勘定	36	121
その他の包括利益合計	238	19
四半期包括利益	1,476	1,480
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,452	1,452
非支配株主に係る四半期包括利益	24	28

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

3. 補足情報

(品目別販売実績)

品目別	前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)		増減率 (%)	前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)		金額 (百万円)	構成比 (%)
メモリー	77,226	51.7	97,333	65.4	26.0	109,292	55.3
システムLSI	34,140	22.8	29,958	20.1	△12.2	41,048	20.8
半導体小計	111,366	74.5	127,291	85.5	14.3	150,340	76.1
液晶デバイス	28,029	18.8	13,494	9.1	△51.9	33,032	16.7
その他	10,021	6.7	8,156	5.4	△18.6	14,197	7.2
合計	149,416	100.0	148,941	100.0	△0.3	197,569	100.0

(メモリー半導体)

DRAM、NAND等の供給緩和による価格下落の中、サーバー・ストレージ向けおよび車載向けDRAM、またスマートフォン向けMCPの販売がそれぞれ好調であり、この分野の売上高は973億33百万円（前年同期比26.0%増）となりました。

(システムLSI)

中国でのスマートフォン市場の減速により、CISが伸び悩んだこと、および、DDIの販売が大きく減少したことにより、この分野の売上高は299億58百万円（同12.2%減）となりました。

(液晶デバイス)

デジタルサイネージ向けの販売は比較的堅調であったものの、中国現地テレビメーカー向けビジネスが低調であったことから、この分野の売上高は134億94百万円（同51.9%減）となりました。

(その他)

MLCCの需給逼迫感は緩和傾向にありますが引き続き売上を牽引、また、工作機等向けにバッテリーの販売も伸びたものの、有機ELの販売が大きく減少したことから、この分野の売上高は81億56百万円（同18.6%減）となりました。

(ご参考)

「メモリー」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

DRAM、NAND FLASH、MCP（マルチチップ・パッケージ）、SSD（ソリッドステートドライブ）等

「システムLSI」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

SoC（システム・オン・チップ）、DDI（ディスプレイドライバーIC）、CIS（CMOSイメージセンサー）等

「液晶デバイス」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LCD（液晶パネル）等

「その他」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LED、有機EL、MLCC（積層セラミックコンデンサー）、バッテリー等